

INHALT

August 2020



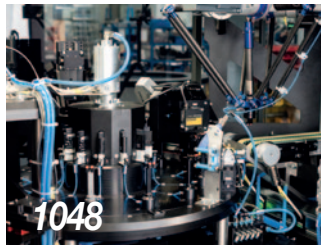
1090

Spielfreie Präzisionsbewegung in Mikroschritten: Piezomotoren lassen sich auch in der Elektronikfertigung für Positionierungsaufgaben einsetzen



1044

Mittels Embedding-Technologie haben Fhg-IAF-Forscher GaN-Power-ICs integriert



1048

In einem Pilotprojekt wurden bei esmo Mechanik- und Elektro-CAD-Daten integriert



1067

NTI-100, Ausgabe 2019: Dr. Nakaharas Listung der wichtigsten Leiterplattenhersteller

EDITORIAL

Führungsaufgabe für Online 1025

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 1029

Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 1042

BAUELEMENTE

Modular: GaN-auf-Si-Halbbrückenschaltungen auf PCB 1044

DESIGN

ECAD und MCAD über PDM verbunden 1048

Die mechatronische Stückliste „lebt“ 1048

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrickeit):
Digitale Gesundheitsangebote schaffen neue Anwendungen 1061

Die Top-100-Leiterplattenhersteller der Welt im Jahr 2019 1067

Umweltbewusstsein mit Zertifikat nachgewiesen 1082

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Minimale Abmessungen – maximale Spielfreiheit 1090

ANALYTIK & TEST

Große Temperaturbereiche gleichzeitig abbilden 1095

Neue automatisierte Baugruppenidentifikation 1097

Realistischere Testverfahren 1097



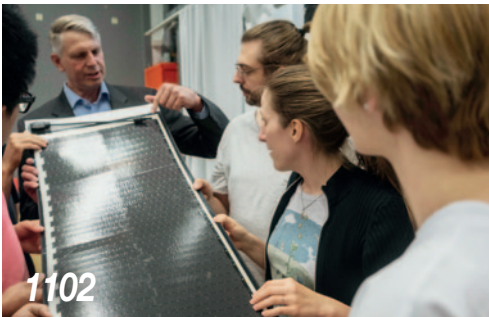
ventec
INTERNATIONAL GROUP
騰輝電子

Höchste Qualitätsstandards für Aerospace & Defense durch AS9100 Rev C Zertifizierung



1097

Mit festinstallierten Kamerasystemen erreicht das EMS-Unternehmen kortec aus Sinsheim Transparenz und Rückverfolgbarkeit



1102

Industriell anwendbare Laserstrukturierung bringt Produktionsausstoß und Leistung von CIGS-Dünnschicht-Solarzellen auf ein neues Niveau

ANALYTIK & TEST

Druckschablonen gewaschen 1098

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Dünnschicht-Solarzellen: Laserstrukturierung
industriell anwendbar 1102

Patente 1105 ▶



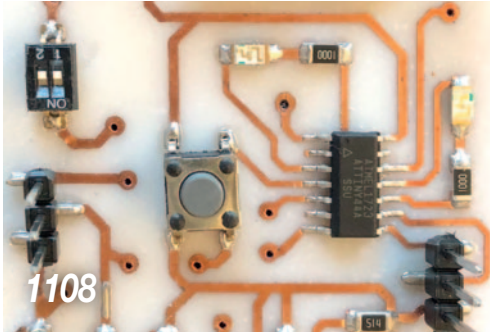
Leiterplattenhersteller aus der Luft- & Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100 Rev C-akkreditierte Lieferkette für hochzuverlässige Basismaterialien und Prepregs. Von der Herstellung bis zur Lieferung ist unser gesamtes qualitativ hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, FR4 und unserer 'tec-speed' Serie von High-Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt. Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact@ventec-europe.com

Follow @VentecLaminates



Ergebnisse des Projekts 'bioESens' für biologisch abbaubare Sensorwerkstoffe stellt die HTW Dresden coronabedingt erstmals hier vor

FORUM

Bericht aus Dresden: Nachhaltigkeit in der Elektronik und Sensorik	1108
Kolumne: Alles Vortreffliche ist ebenso schwierig wie selten	1115
PLUS-Firmenverzeichnis	1118
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	1146
Stellenanzeigen	1147
Inserentenindex	1148
Mediadaten	1149
Impressum	1151
Produkt des Monats	1152

Titelbild

Die neue 3D XE Serie: Das sind leistungsstarke AOI-Systeme für den Inline- oder Stand-Alone-Einsatz. Sie bieten volle 3D-AOI-Funktionalität, höchste Flexibilität sowie einen äußerst attraktiven Preis - und das alles Made in Germany.

Die Systeme Advanced Line · 3D XE und Basic Line · 3D XE eignen sich optimal für kleine und mittlere Losgrößen und bieten zudem die Einsatzmöglichkeit als vollwertiges Lotpasten-Inspektionssystem. Mit MagicClick steht dem Anwender eine leistungsstarke, KI-basierte Funktion zur Verfügung, um Prüfprogramme und Bibliotheken in wenigen Minuten vollautomatisch zu erstellen und zu optimieren.

Weitere Informationen: www.goepel.com

Die Fachzeitschrift PLUS enthält exklusive Mitglieder-Informationen folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente Distribution e. V.
Tel. +49 8563 9788908
a.falke@fbdi.de, www.fbdi.de

1046



Fachverband Elektronik-Design e. V.
Tel. +49 30 340 60 30 50
info@fed.de, www.fed.de

1053



EIPC – Der Europäische Elektronik-Verband
Tel. +31 46 4264258
www.eipc.org

1066



Fachverband Electronic Components and Systems
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

1085



Fachverband PCB and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY – Deutschland e. V.
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

1093



Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V.
Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de

1099



DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.
Tel. +49 211 1591-0
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

1106